

# 深圳市龙图光罩股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

证券简称：龙图光罩

证券代码：688721

编号：2025-005

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别     | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）                                                                                                                                                                                                                                   |
| 参与单位名称及人员姓名   | 中信证券、国泰海通、中银国际、光大证券、长城证券、国海电子、博芮投资、鼎元永辉、远东宏信、创华投资、和君咨询、穗江律所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 时间            | 2025 年 8 月 29 日星期五下午 3:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 地点            | 深圳市龙图光罩股份有限公司会议室                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 上市公司接待人员姓名    | 1、董事会秘书：邓少华<br>2、证券事务代表：李建东<br>3、证券法务专员：丁子善                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p><b>一、公司基本情况</b></p> <p>深圳市龙图光罩股份有限公司成立于 2010 年，是具备关键技术攻关能力，拥有自主知识产权的独立第三方半导体掩模版厂商，主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售。</p> <p>自 2024 年 8 月公司完成科创板挂牌上市以来，公司不断增加投入进行技术攻关和产品迭代，半导体掩模版工艺能力从 130nm 逐步提升至 65nm，并已完成 40nm 工艺节点的生产设备布局，产品广泛应用于信号链及电源管理 IC 等成熟制程，以及功率器件、MEMS 传感器、先进封装等特色工艺制程。公司于 2022 年 8 月设立珠海市龙图光罩科技有限公司，紧随国家半导体行业发展战略，围绕高端半导体芯片掩模版领域持续加大研发投入，逐步实现高端制程的国产化配套，成为国内一流、国际领先的半导体光罩标杆企业。</p> <p><b>二、投资者互动交流</b></p> <p><b>1、公司如何看待 2025 年上半年经营业绩出现下滑？</b></p> <p>回复：公司 2025 年上半年营业收入同比下降 6.44%，归属于上市公司股东的净利润同比下降 28.93%，但二季度下滑幅度开始收窄。主要原因系公司</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>针对部分客户进行了策略性降价导致毛利率有所下降，增加研发投入和业务开拓力度导致期间费用上升，同时珠海新厂投产前期折旧金额增加。部分客户由于经营场地调整，订单量暂时性减少。</p> <p>为应对业绩下滑，公司计划通过以下措施实现增长：（1）深挖现有产能，优化产品结构，增加高精度掩模版的收入占比，持续提升产品附加值；（2）加快募投项目产能爬坡的速度；（3）继续加大研发投入，增加高端制程的技术研发，拓宽产品覆盖的制程节点；（4）积极拓展市场，深化与国内晶圆厂及设计公司的合作，扩大市场份额；（5）不断提高运营效率，推进国产材料使用，严格控制各项成本费用支出。</p> <p><b>2、珠海公司目前项目进展如何，产能爬坡周期的预计需要多少时间？</b></p> <p>回复：2025 年上半年，龙图光罩珠海项目顺利投产，公司第三代掩模版 PSM 产品取得显著进展。公司 KrF-PSM 和 ArF-PSM 陆续送往部分客户进行测试验证，其中 90nm 节点产品已成功完成从研发到量产的跨越，65nm 产品已开始送样验证，已完成 40nm 生产设备的布局，公司在高端制程的影响力进一步增强，覆盖的下游领域更加丰富。该项目年规划产能 1.8 万片，预计达产后产值 5.4 亿元。珠海公司二季度已开始小规模量产，预计 2025 年下半年将逐步放量，公司将通过“高端制程突破+客户结构升级”双引擎驱动业绩增长。</p> <p><b>3、国内掩模版市场国产化率较低，这是否为公司提供了广阔的市场？</b></p> <p>回复：根据中国电子协会官网数据显示，目前中国半导体掩模版的国产化率 10%左右，90%需要进口，高端掩模版的国产化率仅约 3%，半导体光罩行业国产替代空间广阔。在供应链安全需求、国家政策支持、下游晶圆制造产能转移以及国内企业技术突破和产能扩张等共同因素驱动下，为国产掩模版企业提供了广阔的发展空间。</p> <p><b>4、芯片设计公司 with 光罩厂之间具体是什么关系？</b></p> <p>回复：芯片设计与光罩厂是半导体产业链中紧密协作、相互依存的上下游关系。光罩作为芯片设计与晶圆制造的关键桥梁，其质量直接决定芯片的性能与良率。</p> <p>芯片设计公司完成电路设计后，需将设计数据（GDSII 格式）交由光罩厂。光罩厂根据设计版图和晶圆制造厂商的制版工艺要求，制作出同时满足两者要求</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

的、用于晶圆加工的半导体掩模版。

#### **5、无掩模光刻技术是否会替代当前的技术？**

回复：无掩模光刻技术核心优势在于灵活性高、周期短，特别适合研发验证、原型制作、小批量多品种的生产场景，目前主要应用于 PCB 及 IC 载板、低世代显示面板产线及部分封装等领域。目前在高端半导体芯片制造过程，无掩模技术仍面临生产效率瓶颈、套刻精度挑战、现有设备无法直接升级等局限，虽然无掩模技术省去了掩模成本，但其单片加工时间过长，导致每片晶圆综合成本在量产时反而更高，不具备经济上的可行性。因此，无掩模光刻技术主要是传统光刻技术在特定领域的有力补充，而非简单的替代关系。

#### **6、随着半导体掩模版行业竞争的加剧，公司的毛利率是否能保持？**

回复：随着半导体掩模版行业竞争的加剧，以及公司持续进行技术升级和产能扩张，预计未来公司毛利率可能会出现一定程度的下降，主要原因系公司为提升技术能力和扩大产能而投入的新建产线及设备将导致折旧金额显著增加，这部分固定成本的上升会对毛利率产生一定的压力。

面对毛利率下降的压力，公司将通过多项举措减少其不利影响，以维持毛利率的相对稳定：（1）产品结构优化：公司将持续推动产品结构向更高精度、更高附加值的产品升级；（2）技术升级与成本管控：公司将持续进行技术迭代和工艺优化，通过提升良率、优化原材料采购和供应链管理等方式降本增效；（3）规模效应显现：随着新产能的释放和营收规模的扩大，固定成本得以摊薄，有助于减轻单位产品所分摊的折旧压力。

综上，虽然行业竞争加剧和设备折旧增加可能使毛利率面临下行压力，但公司通过产品结构优化、技术升级和成本控制等措施，有望将毛利率保持在合理水平，避免出现大幅波动。

#### **7、公司设备的国产化程度如何？**

回复：公司目前的光刻机和检测设备仍主要依赖进口，这是当前半导体产业，特别是高端制造领域的普遍现状。目前国内光刻机技术在科研领域、PCB 和先进封装等领域已部分实现量产和应用，但在晶圆制造环节，国产设备仍有差距，高端光刻机及检测设备市场仍由国际巨头主导。

公司深知供应链自主可控的重要性，并始终积极支持和推动国产化设备使用的进程。目前公司的策略是在

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>保障当前生产稳定性和产品良率的同时，审慎评估、验证并逐步引入合格的国产设备。</p> <p><b>8、公司面对当前的竞争环境，是否有些经营策略上的调整？</b></p> <p>回复：在 130nm 及以上制程半导体掩模版领域，伴随国产替代进程加速，行业竞争有所加剧，公司为了应对上述竞争环境的变化，巩固核心客户合作黏性，对部分客户适度让利，采用阶段性降价策略。</p> <p>同时，2025 年上半年公司看好未来先进封装的发展机遇，伴随摩尔定律失效以及高算力芯片的广泛应用，先进封装的重要性日益凸显，通过系统重构、缩短互联长度等工艺进一步提升芯片性能，是如今 AI 等高算力芯片不可或缺的技术。公司上半年持续开拓先进封装领域客户，通过将市场与技术资源倾斜，成功开拓了天成先进等封装客户，并加深了与华天科技等客户的合作。</p> |
| 附件清单（如有） | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 日期       | 2025 年 8 月 29 日星期五                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |